

Title (en)
Earthing clip and earthing assembly

Title (de)
Erdungs-Clip und Erdungsverbund

Title (fr)
Clip de mise à la terre et assemblage de mise à la terre

Publication
EP 2528166 A1 20121128 (FR)

Application
EP 12168493 A 20120518

Priority
FR 1154522 A 20110524

Abstract (en)
The clip (1) has first and second wings (2, 3) and a base (4) defining a longitudinal slot (5) for receiving an edge of a support. The wings are traversed by a transversal slot (6) that is arranged perpendicular to the longitudinal slot. The slots are opened on same side of the clip such that width of the longitudinal slot is increased toward the base on a wing portion of the first wing, and simultaneously width of the transversal slot is decreased for cutting an insulating sheath during insertion of a ground wire in the transversal slot. The clip is formed from a metallic plate.

Abstract (fr)
L'invention concerne un clip de mise à la terre (1) définissant une fente longitudinale (5) et une fente transversale (6) perpendiculaires et débouchant du même côté, ladite fente longitudinale (5) recevant l'engagement d'un support (100), ladite fente transversale (6) recevant l'engagement d'un fil de terre (10) comportant une âme conductrice (11) et une gaine isolante (12), ledit fil de terre (10) étant coincé entre ledit support (100) et le fond de ladite fente transversale (6), la largeur de ladite fente longitudinale (5) augmentant vers ladite base (4) sur au moins une "première" portion d'aile (P1) et simultanément, sur au moins une "première" partie (P11) de ladite "première" portion d'aile (P1), la largeur de ladite fente transversale (6) diminuant pour sectionner ladite gaine isolante (12). L'invention concerne également un assemblage de mise à la terre comprenant un tel clip de mise à la terre (1).

IPC 8 full level
H01R 4/24 (2006.01); **H01R 4/26** (2006.01); **H01R 4/48** (2006.01); **H01R 11/22** (2006.01); **H01R 13/648** (2006.01)

CPC (source: EP)
H01R 4/2416 (2013.01); **H01R 4/26** (2013.01); **H01R 4/4809** (2013.01); **H01R 11/22** (2013.01); **H01R 13/648** (2013.01)

Citation (applicant)
• FR 2694141 A1 19940128 - CIT ALCATEL [FR]
• US 6106310 A 20000822 - DAVIS WAYNE SAMUEL [US], et al
• US 3528050 A 19700908 - HINDENBURG EUGENE D
• US 4456321 A 19840626 - JONES PHILIP N [US], et al
• US 5451167 A 19950919 - ZIELINSKI JAMES S [US], et al

Citation (search report)
• [IY] US 2009111311 A1 20090430 - WEBER RONALD MARTIN [US]
• [YDA] US 6106310 A 20000822 - DAVIS WAYNE SAMUEL [US], et al
• [YA] WO 8602131 A1 19860410 - AMP INC [US]

Cited by
FR3002089A1; EP2835869A1; EP3361576A1; CN110247305A; JP2022510160A; US11668332B2; US10381765B2; US11616468B2; US11885139B2; US11774143B2; US11573033B2; US11788291B2; WO2019239024A1; US11808043B2; US11333179B2; WO2016193615A1; US10141662B2; US11352793B2; US11512474B2; US11739529B2; US11876482B1; US11965337B2

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 2528166 A1 20121128; EP 2528166 B1 20150909; FR 2975835 A1 20121130; FR 2975835 B1 20140516; PL 2528166 T3 20160331

DOCDB simple family (application)
EP 12168493 A 20120518; FR 1154522 A 20110524; PL 12168493 T 20120518